電子部品実装装置

プリント基板への表面実装部品の実装、および両面基板の試作に必要なスルーホール加工を行う装置

[型式]

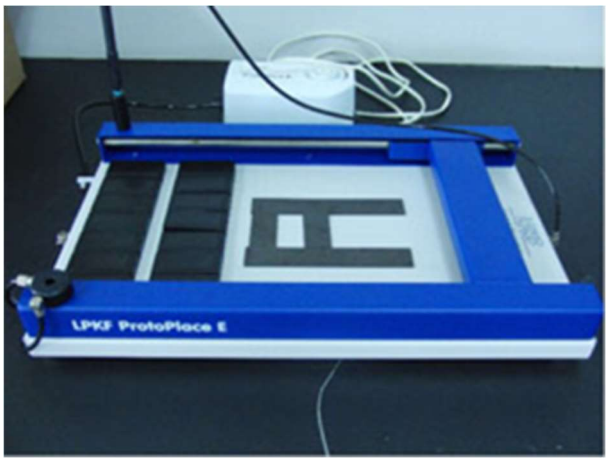
部品実装装置	SMT E-Line (LPKF 社製)
スルーホール加工装置	ProConduct (LPKF 社製)

[仕様]

部品実装装置	最大基板寸法	: 160×200㎜
	搭載可能最小部品寸法	: 0.6×0.3㎜
スルーホール加工装置	最大基板寸法	: 305×229㎜
	加工可能穴径	: 0.4㎜

[設置年度]

2013 年度（平成 25 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日